



סמסונג מתכננת לשנות את מפת הדרכים הטכנולוגית שלה בתחום תהליכי הייצור ומטרתה להביא את תהליך 6nm שלה לייצור בנפח מסחרי במחצית השנייה של 2019. כך עולה מדיווחי התקשורת בקוריאה. מדובר בהקדמה של חצי שנה לפחות לעומת התכנון המקורי.

לדברי מומחים, נראה שסמסונג פיגרה מאחורי TSMC בפיתוח של תהליך 7nm, ולכן היא מתכוונת להאיץ את תהליך 6nm, כך שיוכל להתחרות ביעילות עם TSMC עבור שבבים מתקדמים שאפל וקוואלקום מתכננות להוציא לשוק בשנת 2019.

של המוני בייצור ותחל שלה 7nm תהליך עבור טייפאאוטים 13 קיבלה היא כי לאחרונה דיווחה TSMC שבבים בתהליך זה ב-2018. TSMC גם זוכה לנתח גדול מהזמנות ייצור שבבי baseband שלה בתהליך 7 ננומטר. עם זאת, קוואלקום עדיין לא החליטה היכן לייצר את הדור הבא של מעבדי היישומים שלה עם ייצורם הם תהליך ובאיזה סמסונג או TSMC אשר, (EUV) קיצוני סגול אולטרה באמצעות 7nm תהליך של משופרת גרסה עבור פ"במו עוסקת TSMC יהיה מוכן לייצור בנפח גדול בשנת 2019, אמר Wei CC מנכ"ל משותף של TSMC בכנס המשקיעים האחרון של החברה. ב שלה המשופר EUV + 7nm תהליך עם אפל של הבא הדור של בהזמנות ולזכות להמשיך צפויה TSMC 2019- תוך שהיא מקדימה את תהליך ה- 7nm של סמסונג, שאמור להיכנס לייצור ניסיוני ב-2018, אמרו המקורות.

על מנת להדביק את TSMC, סמסונג תתקין שתי מכונות ASV של ASML בסוף שנת 2017 ותוסיף שבע יחידות דומות ב-2018, על פי דיווחים בתקשורת בקוריאה. מכיוון שמערכות EUV ASML מסוגלים לתמוך בתהליכי הייצור 7-, 6- ו-5nm, סמסונג צפויה לבצע שינויים בצידוד 7nm שלה כדי שתוכל לייצר בטכנולוגיית המקורות ציינו, 6nm.

עוד בנושא:

[ברבעון ביותר הגדולה השבבים ספקית ולהיות אינטל את לעקוף עשויה סמסונג IC Insights השני של 2017](#)

{loadposition content-related}

)